

【共同技研化学株式会社】

モバイル機器用基材レス極薄両面テープの開発

開発のねらい

モバイル電子機器、特にディスプレイ部やケースの組立・接合に使用可能な、従来の技術では達成できなかった高透明かつ高い接合力を有する基材レス極薄の接着両面テープの開発すること。

開発の概要

弊社独自の「分子勾配膜」技術を用いて、構成・原料を最適化する事で「透明性」「接合力」を向上させ従来の両面テープでは実現できなかった高透明両面接着テープを開発する。

特長

分子量にグラデーションかける事を実現した弊社独自技術の基材レス接着両面テープ「分子勾配膜」技術を応用・最適化する事で、テープ厚み全てが被着体界面との密着に寄与させる事を実現し、従来の両面テープと比較し1.5倍～2.0倍の接合力を有する。また、透過率に優れるアクリル系の原料のみで構成される為、全光線透過率92%以上の高透明性を実現する。

分子勾配膜構成

低分子アクリル接着層

高分子アクリル接着層

低分子アクリル接着層

分子量のグラデーションを実現。
高接合力・高透明性を有する。

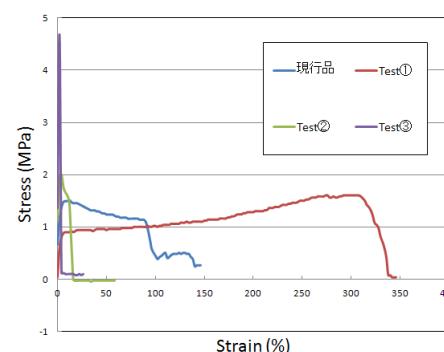
用途

モバイル電子機器の組立・固定

最適化検証測定例

高分子層 高分子層厚み(μm)	10	test①			test②			test③		
		30	50	10	30	50	10	30	50	
密着強度 (N)	179	232.1	196.5	169.2	200.6	152.2	159.2	162.5	122.8	

打ち抜き試験測定結果



引張強度測定結果

お問い合わせ先

【所在地】 〒370-2321 群馬県富岡市岡本1280 (本社:埼玉県所沢市)

【連絡先】 TEL 0274-70-2611 富岡工場 技術課 岩崎

<http://www.kgk-tape.co.jp/>

